

連結財務諸表

注：連結財務諸表の数値は百万円以下を切り捨てて表示しています。

連結貸借対照表

単位：百万円

科目	前連結会計年度 (08.03.31)	当連結会計年度 (09.03.31)
(資産の部)		
流動資産	77,603	50,256
固定資産	30,063	31,575
有形固定資産	18,969	19,948
無形固定資産	3,188	2,905
投資その他の資産	7,905	8,721
資産合計	107,667	81,831
(負債の部)		
流動負債	44,540	24,862
固定負債	7,640	16,139
負債合計	52,180	41,001
(純資産の部)		
株主資本	55,081	41,712
資本金	9,633	9,650
資本剰余金	20,653	20,668
利益剰余金	24,900	11,500
自己株式	△105	△107
評価・換算差額等	29	△1,289
その他有価証券評価差額金	65	△963
為替換算調整勘定	△35	△326
新株予約権	375	408
純資産合計	55,487	40,830
負債純資産合計	107,667	81,831

連結損益計算書

単位：百万円

科目	前連結会計年度 (07.04.01～08.03.31)	当連結会計年度 (08.04.01～09.03.31)
売上高	91,823	45,741
売上原価	67,763	37,709
売上総利益	24,060	8,032
販売費及び一般管理費	13,609	10,498
営業利益又は営業損失(△)	10,450	△2,466
営業外収益	545	430
営業外費用	1,619	801
経常利益又は経常損失(△)	9,375	△2,838
特別利益	7	3
特別損失	165	10,903
税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△)	9,217	△13,738
法人税、住民税及び事業税	2,976	936
法人税等調整額	1,427	△3,476
当期純利益又は当期純損失(△)	4,813	△11,198

連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

科目	前連結会計年度 (07.04.01～08.03.31)	当連結会計年度 (08.04.01～09.03.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,014	2,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,483	△3,257
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,815	2,624
現金及び現金同等物に係る換算差額	△26	△299
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,310	1,921
現金及び現金同等物の期首残高	16,800	15,665
連結範囲変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少)	175	－
現金及び現金同等物の期末残高	15,665	17,586

連結株主資本等変動計算書

単位：百万円

第86期 (08.04.01～09.03.31)	株主資本				株主資本 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	
平成20年3月31日残高	9,633	20,653	24,900	△105	55,081
在外子会社の会計処理の変更に伴う増加額			9		9
当期連結会計期間中の変動額					
新株の発行	16	16			32
剰余金の配当			△2,210		△2,210
当期純損失			△11,198		△11,198
自己株式の取得				△2	△2
自己株式の処分		△0		1	0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	16	15	△13,409	△1	△13,378
平成21年3月31日残高	9,650	20,668	11,500	△107	41,712
第86期 (08.04.01～09.03.31)	評価・換算差額等			新株 予約権	純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成20年3月31日残高	65	△35	29	375	55,487
在外子会社の会計処理の変更に伴う増加額					9
当期連結会計期間中の変動額					
新株の発行					32
剰余金の配当					△2,210
当期純損失					△11,198
自己株式の取得					△2
自己株式の処分					0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,028	△290	△1,319	32	△1,287
当期変動額合計	△1,028	△290	△1,319	32	△14,665
平成21年3月31日残高	△963	△326	△1,289	408	40,830



第86期 株主通信

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

株式会社 東京精密

ごあいさつ

株主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

第86期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の株主通信をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

当期の当社を取り巻く経営環境は、米国に端を発した金融危機が実体経済に波及し、世界同時不況の下、非常に厳しい状況で推移しました。

半導体製造装置部門につきましては、半導体の需給バランス悪化に伴うDRAMやNANDフラッシュの価格下落などから、半導体メーカーの設備投資の抑制や繰延が相次ぎ、業績は低調でありました。

計測機器部門の業績は、上期は順調に推移しましたが、下期の受注・売上は、リーマンショック後の自動車業界や工作機械業界などの急激な販売・生産の縮小の影響を受けて、大きく落ち込みました。

この結果、当期の受注高は330億74百万円(前期比59.6%減)、売上高は457億41百万円(同50.2%減)、営業利益は△24億66百万円(同129億16百万円減)、経常利益は△28億38百万円(同122億13百万円減)となりました。また、当期純利益は半導体事業の事業見直し及びたな卸資産評価損等特別損失109億3百万円を計上したことから△111億98百万円(同160億12百万円減)となりました。

半導体装置部門

半導体市場は、在庫調整が概ね完了しつつあることや、中国市場の需要拡大などもあり、緩やかな回復局面に入りつつありますが、半導体メーカーは、設備投資についてはなお慎重姿勢で臨むと見込まれ、当社の半導体製造装置部門は、

厳しい経営環境が続くと予想しています。

以上より半導体製造装置部門の平成22年3月期の売上高は前期比減少を余儀なくされ、160億円(前期比35.3%)を予想しています。

計測機器部門

計測機器部門の主なお客様である自動車業界の平成22年3月期の生産・販売は、世界同時不況の影響で前年を大きく下回ると予想されており、自動車関連メーカーや工作機械メーカーは、設備投資を抑制しています。この影響により、計測機器部門の平成22年3月期の売上高は、前年比減少を避けられず、100億円(前期比52.4%減)を予想しています。

今後とも、不透明な状態が続くと思われる事業環境の下、配当につきましては、上期は赤字が見込まれることから、中間配当見送りを予定いたしております。期末配当につきましては、今後の業績を踏まえ検討させていただきます。

東京精密はこれからも「健康・安全」、「品質・顧客満足」、「環境・省エネルギー」を、経営の柱とし、培ってきた精密加工技術と精密測定技術を生かして、優れた半導体製造装置と精密機器を開発・供給することにより、社会に貢献して参ります。

株主の皆様方におかれましては、今後とも倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長
藤森 一雄

藤森 一雄

会社概要

(2009年3月31日現在)

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)	国内拠点	業務会社 半導体社 計測社 半導体関連営業所 計測関連営業所 グループ会社	東京都三鷹市 東京都八王子市 茨城県土浦市 4ヶ所 17ヶ所 5社 16拠点
設立	1949年3月28日	海外拠点	北アメリカ ヨーロッパ アジア	4ヶ所 4ヶ所 16ヶ所
資本金	9,650,322,063円			
証券取引所 会社が発行する	東京証券取引所 市場第一部			
株式の総数	110,501,100株			
発行済株式 の総数	40,240,581株 (うち、自己株式数31,171株)			
株主数	33,584名			
役員 (2009年6月29日現在)	代表取締役社長 藤森 一雄 代表取締役CFO 太田 邦正 業務会社執行役員社長 取締役 梅中 茂 取締役 ウォルフガング ボナツ 取締役 吉田 均 計測社執行役員社長 取締役 木村 龍一 半導体社執行役員社長 業務会社執行役員常務 川村 浩一 監査役(常勤) 高城 英明 監査役 高田 宥 監査役 大井 弘雄			
従業員数	737名(単体) 1,221名(連結)			
主要取引銀行	みずほコーポレート銀行大手町営業部 三井住友銀行本店営業部 みずほ信託銀行本店営業部 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店 常陽銀行土浦支店 関東つくば銀行本店営業部 りそな銀行吉祥寺支店			

所有者別状況 (株式数比率)



株主メモ

事業年度	毎年4月1日～翌年3月31日
剰余金の配当 基準日	3月31日 (中間配当を行う場合は9月30日)
定時株主総会	毎年6月下旬
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
特別口座 お問い合わせ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部 TEL：0120-288-324 (フリーダイヤル)
	※住所変更等の事務手続きは、 お取引証券会社等にてお手続きください。
公告方法	電子公告(ホームページ) ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

TOKYO SEIMITSU
http://www.accretech.jp

社長インタビュー

当期業績をどのように評価されていますか？

半導体事業、計測事業とも前年比減収・減益となり全般的に厳しい結果となりました。米国のサブプライム問題に端を発した、世界的な不況の影響により、主要な需要家である半導体、自動車の需要減、設備投資の抑制のため、特に第3、第4四半期の失速が顕著でした。

市場環境について伺います。

米国の金融危機に端を発した世界的不況の影響を大きく受け、半導体事業、計測事業とも非常に厳しい状況にあります。半導体製造装置事業に関しては、前半の落ち込みが大きく、今年度通期実績が前年度を下回ることは避けられない状況ですが、下期には前年比増に転ずるものと考えております。計測事業に関しては、私どもの主な需要家である自動車・工作機械業界の低迷が続き、今年度も厳しい状況が続くものと考えております。回復は来年度以降で緩やかなものになると考えております。

固定費の削減については如何でしょうか？

固定費削減のメインは人件費削減ですが、これを人員削減、報酬・給与等の減額、一時帰休によって実施いたします。従業員数は、1年前に正社員と臨時従業員で2,200名近くでしたが、厳しい事業環境を踏まえ希望退職を募るなどを行って、1,200名を切る体制といたしました。報酬・給与等につきましては、既に役員報酬と給与の減額を実施しておりますが、4月以降、減額幅を更に拡大しております。その他の経費につきましても、販売促進費・広告費削減、旅費・交通

費削減など、きめ細かく、聖域のない取り組みを行っております。こうした取り組みにより09年度は08年度に比べ固定費を4割削減する目処をつけております。

回復期に向けた体制整備についてお聞かせください。

【海外営業体制の再構築】

顧客別のアカウント管理体制を明確化し、グローバル展開をする顧客の内外の情報を共有化することにより、緊密に連携できる体制としました。特に中国市場について、現地での代理店組織化や拠点網の拡充、人員増強などに注力して取り組んでおります。

【開発体制の再構築】

技術部門をワンフロアに集約し技術者間の情報共有を進め、開発の効率化を促進する環境を整えました。加えてこれまでほとんど行ってこなかった半導体と計測の技術者交流人事を行うことで一層の活性化を促進したいと考えております。

【製造体制の再構築】

製品横断的に対応できる多能工の育成による混流生産体制の確立を進めております。これにより、回復時にも機動的な生産体制を組めると考えております。

【サービス(受託加工、改造等)売上増強】

こうした分野へのニーズの高まりに応えるため、営業・サービス・技術の情報連絡会を設け緊密に連携できる体制を整備いたしました。オプションのパッケージ化を行い、従来以上に積極的に営業を進めております。

更なる成長への取組み

【半導体製造装置】

現在、足元でもっとも活発な動きとして注目されるのが、CMOSイメージセンサやLEDであり、これに対応するのがレーザーダイサなどになります。次に既に見えているのがSSDです。これに対応してPG、プローバを伸ばしていきたいと考えております。その次に、漸くTSVの出番が来ると考えられます。ここでは、当社の数多くの製品群がその力を発揮する局面になると考えております。

【計測機器】

非自動車向け大型製品、新興国向け低価格機、省エネ機種を重要テーマとして、開発に注力しております。非自動車向け大型製品は、自動車業界への依存度引き下げを図るべく、風力発電、航空機分野向けの戦略品として開発に注力しています。また、成長が期待される中国などの新興国向けを念頭に、粗さ計や真円度測定機において、低価格機の開発や、昨今のエコへの一層の取り組みを踏まえ省エネ機種の開発にも精力的に取り組んで参ります。

配当について

配当につきましては、上期は赤字が見込まれることから、中間配当は見送りを予定させていただいております。期末配当につきましては、今後の業績動向を踏まえて検討してまいります。株主の皆様には何卒ご理解のほどお願いしたいと存じます。

現在、東京精密は非常に厳しい事業環境の下にあります。しかしながら、私たちは何もしないで市況の好転を待っているわけではありません。より大きな成長を目指し、さまざまな角度から、さまざまな手を打っています。これからの成果として花開き、私たちが掲げる「WIN-WIN」のすべての関係者が利益を享受できるまで、もうしばらくご辛抱いただきますようお願いいたします。

今話題の業界

その1 航空機業界

三次元座標測定機

MMZ-G(フロア設置・ブリッジ移動型)

このタイプの特長は、大型部品の高精度測定に対応できる構造となっており、大型ワークかつ加工精度の高い部品、工作機械ベース、航空機部品、風力発電用部品などの測定に適しています。

MMZ-B(フロア設置・ガントリー型)

このタイプの特長は、三次元測定機の大型化に最も適した構造であり、大型プレート(鉄、ガラス)、大型船舶用スクリュー、航空機部品やタービンブレードなどの測定に適しています。



MMZシリーズ

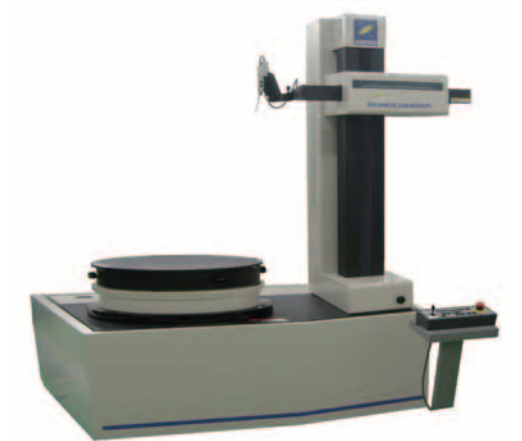
その2 エネルギー産業

真円度測定機

ロンコム65A

「検出器回転タイプ」の真円度測定機で、真円度測定が必要な大型ワークとしては、マシニングセンタなどの工作機械の主軸のスピンドルや高速列車の車軸、半導体製造装置用のレンズマウント、発電用の風車やタービンのベアリングや主軸があります。自動車関連では、エンジンのシリンダーブロックのボアやクランクシャフトなどで使用されています。

これらの産業に共通して言えることは、いずれも重厚長大産業であり被測定物も大きく、通常の測定室用の測定機では困難であり、測定機も大型タイプが必要になります。



RONDCOM 65A

製品群

半導体

マホーダイシングマシン (ML300)

新開発エンジンを搭載した新型レーザーダイサ。



計測

研削盤用オートバランス (PULCOM AB-10)

砥石の動的バランスを自動調整。高精度加工の必需品。



コントローラ



バランスヘッド、給電部

ウェーハブローピングマシン (UF3000EX)

専用駆動ユニットによる高速・高静粛XYステージを採用し、驚異的なスループットを実現。



小型CNC三次元座標測定機 (DuraMax)

小型スキャニングセンサー「VAST XXT」を標準装備。生産現場でのあらゆる測定要求に対応し、この1台で応えます。

DuraMax (デュラマックス)



代表取締役社長 藤森 一雄